

型番	導体成分	用途/特徴	比抵抗 ($\mu\Omega\cdot\text{cm}$)	塗布方法	接着強度	推奨硬化/ 焼成条件	対応基板
Type	conductor component	Application and Characteristics	Specific resistivity	Coating method	Adhesive strength	Curing/Sinteri ng schedule	Substrate
HS109	Ag	耐イオンマ イグレー ション性、 はんだ濡れ 性良好、 めっき可	≤ 3	スクリーン 印刷	≥ 4	900 °C 10min	Al ₂ O ₃
		Resistant ionic migration, Good soldering, Nickel plateable		Screen printing			
HS201	Ag	めっき可	≤ 4	スクリーン 印刷	≥ 4	900 °C 10min	AlN
		Nickel plateable		Screen printing			
HS301	Ag	はんだ濡れ 性良好、 めっき可	≤ 3	スクリーン 印刷	≥ 2	500-650 °C 10min	Glass
		Good soldering, Nickel plateable		Screen printing			
HS102P	AgPd	Pd2%, Pd5%含 有、耐硫化 性、	Pd2% : ≤ 4	スクリーン 印刷	≥ 4	900 °C 10min	Al ₂ O ₃
		耐イオンマ イグレー ション性、 めっき可	Pd5% : ≤ 6				
		Pd 2%, 5% containing, Sulfur resistance,	Pd2% : ≤ 4	スクリーン 印刷			
		Resistant ionic migration, Nickel plateable	Pd5% : ≤ 6				
HS101T	Ag	スクリーンオフ セット印刷用	≤ 3	スクリーン オフセット 印刷	≥ 4	900 °C 10min	Al ₂ O ₃
		耐めっき性		スクリーン オフセット 印刷			
		For screen offset printing, Nickel plateable					